

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《2023年第三季度報告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二三年十一月九日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事：

孫國棟

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

证券代码：688347

证券简称：华虹公司

华虹半导体有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、 总裁致辞

华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华虹半导体”）总裁兼执行董事唐均君先生对二零二三年第三季度业绩评论道：

“当前宏观环境复杂多变，半导体行情尚未复苏。华虹半导体在艰巨挑战中砥砺前行，于二零二三年第三季度实现了 5.685 亿美元营收，当季毛利率为 16.1%，符合指引预期。随着华虹无锡 12 英寸生产线项目产能爬坡，截至第三季度末，公司折合八英寸月产能增加到了 35.8 万片。在具备了更大规模生产能力的同时，也为新产品的研发上线提供了更强劲的支持。凭借多年来在特色工艺领域的技术积累和多元化工艺平台优势，公司的各项产品，尤其是 IGBT 和超级结，在新能源、汽车电子等领域持续发力，获得了客户的高度认可。”

唐总继续讲道：“公司的第二条 12 英寸生产线--华虹无锡制造项目，正在紧锣密鼓地推进中。目前，该项目处于厂房建设阶段，预计将于 2024 年底前建成投产，并在随后的三年内逐步形成 8.3 万片的月产能，为公司的中长期发展打下坚实基础。即使市场低迷，公司依然注重研发投入和团队建设，持续提高产品质量和各项性能指标，进一步夯实特色工艺晶圆代工龙头地位，以更出色的业绩回馈投资人。”

注：上述涉及的财务数据，与公司同日披露的港股公告《二零二三年三季度业绩公布》中保持一致，存在因实时汇率、会计准则计算方式等原因导致误差的情况。

二、 2023 年第四季度指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期香港财务报告准则下的指引为：

主营业务收入约在 5.6 亿美元至 6.0 亿美元之间；

主营业务毛利率约在 16%至 18%之间。

三、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,108,654,270.64	-5.13	12,952,608,201.89	5.64
归属于上市公司股东的净利润	95,834,147.30	-86.36	1,684,552,665.08	-11.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,698,534.61	-91.11	1,463,834,385.61	-12.79
经营活动产生的现金流量净额	1,220,561,131.90	0.58	3,462,387,309.64	-11.84
基本每股收益(元/股)	0.06	-88.89	1.20	-17.81
稀释每股收益(元/股)	0.06	-88.89	1.20	-17.24
加权平均净资产收益率(%)	0.27	减少 3.55 个百分点	6.64	减少 3.96 个百分点
研发投入合计	411,200,039.00	32.23	1,082,206,194.41	22.61
研发投入占营业收入的比例(%)	10.01	增加 2.83 个百分点	8.36	增加 1.16 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	70,339,994,008.20		47,876,614,340.83	46.92
归属于上市公司股东的所有者权益	42,500,207,451.09		19,844,793,693.32	114.16

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-387,448.63	-494,930.72	无
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	76,348,070.86	322,943,155.71	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,172,897.59	14,469,553.92	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,265.70	142,372.95	该项为本集团按比例享有的联营企业投资收益中归属于联营企业的非经常性损益。
减：所得税影响额	2,082,022.90	21,506,399.70	
少数股东权益影响额（税后）	32,954,149.93	94,835,472.69	
合计	46,135,612.69	220,718,279.47	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)境内外会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本报告期金额	上年同期金额	本报告期末	上年度末
按中国会计准则	95,834,147.30	702,800,526.61	42,500,207,451.09	19,844,793,693.32
按境外会计准则调整的项目及金额：				
采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量	4,175,372.08	4,182,548.22	1,273,768,970.41	1,261,242,854.16
按境外会计准则	100,009,519.38	706,983,074.83	43,773,976,421.50	21,106,036,547.48

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-86.36	主要由于毛利下降、存货跌价损失增加、研发费用增加以及其他收益减少所致，部分被汇兑损失减少所抵消。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-91.11	
基本每股收益_本报告期	-88.89	主要由于归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-88.89	
研发投入合计_本报告期	32.23	主要由于研发工程片投入增加所致。
总资产_本报告期末	46.92	主要由于本报告期内科创板发行股份募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	114.16	

四、股东信息

1.截至本报告期末，本公司于香港已发行 1,308,491,501 股，约占本公司总股本 76.24%，于上交所科创板已发行 407,750,000 股，约占本公司总股本 23.76%。

2.本公司香港股东名册由香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）及其他登记股东组成。香港中央结算（代理人）有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司港股股票。

3.根据香港证券及期货条例，持有本公司 5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需要进行申报披露，公司根据申报披露信息，将香港中央结算（代理人）有限公司所持股份数量剔除了鑫芯（香港）投资有限公司持有的港股 178,705,925 股。

4.A 股股东性质按照中国结算 A 股股东名册中的持有人类别填报。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,677		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	未知	620,465,119	36.15	-	-	未知	-
上海华虹国际公司（Shanghai Hua Hong International, Inc.）	境外法人	347,605,650	20.25	-	-	无	-
鑫芯（香港）投资有限公司（Xinxin（Hongkong） Capital Co., Limited）	境外法人	178,705,925	10.41	-	-	无	-
联和国际有限公司（Sino-Alliance International, Ltd.）	境外法人	160,545,541（注）	9.35	-	-	无	-
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	境内非国有法人	48,334,249	2.82	48,334,249	48,334,249	无	-

国新投资有限公司	国有法人	23,076,923	1.34	23,076,923	23,076,923	无	-
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	23,076,923	1.34	23,076,923	23,076,923	无	-
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	13,461,538	0.78	13,461,538	13,461,538	无	-
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	9,615,384	0.56	9,615,384	9,615,384	无	-
海通创新证券投资有限公司	国有法人	8,155,000	0.48	8,155,000	8,155,000	无	-
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	620,465,119	境外上市外资股	620,465,119				
上海华虹国际公司（Shanghai Hua Hong International, Inc.）	347,605,650	境外上市外资股	347,605,650				
鑫芯（香港）投资有限公司（Xinxin（Hongkong） Capital Co., Limited）	178,705,925	境外上市外资股	178,705,925				
联和国际有限公司（Sino-Alliance International, Ltd.）	160,545,541	境外上市外资股	160,545,541				
吴玉芳	1,112,492	人民币普通股	1,112,492				
丁建荣	898,848	人民币普通股	898,848				
中国中金财富证券有限公司	641,831	人民币普通股	641,831				
海通证券股份有限公司	620,982	人民币普通股	620,982				

四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	577,794	人民币普通股	577,794
韩军	525,823	人民币普通股	525,823
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.上海华虹国际公司、联和国际有限公司（以下简称“联和国际”）均受上海市国资委控制。上海市国资委间接持有上海华虹国际公司 100%的股份，并通过上海联和投资有限公司间接持有联和国际 100%的股份。</p> <p>2.国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）持有本公司子公司华虹半导体（无锡）有限公司 8.4233%的股权，持有本公司子公司华虹半导体制造（无锡）有限公司 29%的股权。大基金二期的私募基金管理人是华芯投资管理有限责任公司（以下简称“华芯投资”），华芯投资作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金一期”）、大基金二期进行管理。鑫芯（香港）投资有限公司（以下简称“鑫芯香港”）系大基金一期通过巽鑫（上海）投资有限公司持股的全资子公司。孙国栋为华芯投资总监，鑫芯香港向本公司提名了孙国栋担任其非独立董事。截至 2023 年 9 月 30 日，持有大基金二期 7.35%股份的股东上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有海通证券股份有限公司 A 股和 H 股合计 10.38%的股份（根据公开信息披露文件，上海国盛（集团）有限公司是海通证券股份有限公司的第一大股东，非控股股东、实际控制人）。</p> <p>3.海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。</p> <p>除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>1.吴玉芳通过普通账户持有 311,648 股，通过信用账户持有 800,844 股；2.韩军通过信用账户持有 525,823 股。</p>		

注：含联和国际以托管方式持有的 3,084 股股份。联和国际全资子公司 Wisdom Power Technology Limited 亦直接持有本公司 28,415,606 股股份，持股比例为 1.66%。

五、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

六、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:华虹半导体有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	36,104,331,029.31	14,067,363,512.96
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	329,841,961.30	445,986,658.26
应收账款	1,981,730,402.29	1,600,593,737.98
应收款项融资	-	-
预付款项	103,696,188.59	20,089,816.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	127,701,402.80	171,603,673.96
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,666,963,230.75	4,964,248,677.08
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	78,258,206.28	151,303,523.11
流动资产合计	43,392,522,421.32	21,421,189,599.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	468,322,347.88	453,745,063.37

其他权益工具投资	1,098,679,659.99	1,244,097,339.99
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	218,257,814.51	232,994,421.87
固定资产	19,912,667,752.55	18,663,711,861.32
在建工程	3,945,103,643.97	4,790,676,996.90
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	142,750,570.30	112,565,333.88
无形资产	634,479,648.69	663,365,339.85
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	319,488.80	403,672.10
递延所得税资产	267,809,870.79	239,944,426.24
其他非流动资产	259,080,789.40	53,920,285.32
非流动资产合计	26,947,471,586.88	26,455,424,740.84
资产总计	70,339,994,008.20	47,876,614,340.83
流动负债：		
短期借款	7,745,929.36	2,187,152,015.09
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,542,115,817.60	1,734,453,650.83
预收款项	20,027,585.97	21,209,980.80
合同负债	750,447,732.08	1,347,300,289.33
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	424,540,114.40	575,182,211.38
应交税费	517,182,744.73	582,388,291.22
其他应付款	1,204,828,563.18	1,941,805,731.60
其中：应付利息	-	-
应付股利	191,116.22	186,042.71
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,309,881,569.40	817,792,802.07
其他流动负债	333,531,341.83	420,672,019.11
流动负债合计	6,110,301,398.55	9,627,956,991.43
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	12,534,344,578.06	10,318,612,710.73
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	133,903,711.33	101,992,389.22
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	191,159,536.28	287,417,660.32
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,859,407,825.67	10,708,022,760.27
负债合计	18,969,709,224.22	20,335,979,751.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,889,702,877.61	12,939,561,724.13
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,837,768,700.86	5,843,845,854.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	-116,126,215.31	-142,923,308.09
专项储备	-	-
盈余公积	1,501,670,644.25	1,243,875,540.27
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,387,191,443.68	-39,566,117.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	42,500,207,451.09	19,844,793,693.32
少数股东权益	8,870,077,332.89	7,695,840,895.81
所有者权益（或股东权益）合计	51,370,284,783.98	27,540,634,589.13
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	70,339,994,008.20	47,876,614,340.83

公司负责人：张素心

主管会计工作负责人：Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）

会计机构负责人：黄英娜

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：华虹半导体有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	12,952,608,201.89	12,260,872,870.42
其中：营业收入	12,952,608,201.89	12,260,872,870.42
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	11,483,645,443.33	10,563,169,792.27
其中：营业成本	9,024,245,034.67	8,078,787,074.21
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	96,169,540.97	70,979,149.65
销售费用	52,751,460.78	62,676,527.69
管理费用	522,787,660.27	487,584,656.51
研发费用	1,082,206,194.41	882,653,769.95
财务费用	705,485,552.23	980,488,614.26
其中：利息费用	567,934,434.82	213,189,090.56
利息收入	290,401,527.97	107,631,112.53
加：其他收益	105,805,733.43	186,435,293.60
投资收益（损失以“-”号填列）	14,577,284.51	34,150,810.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,577,284.51	33,728,410.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,204,806.79	-832,102.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-495,370,884.47	-64,728,882.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-494,930.72	16,995.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,088,275,154.52	1,852,745,192.56
加：营业外收入	14,469,553.92	1,221,376.57
减：营业外支出	-	25,052,513.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,102,744,708.44	1,828,914,056.08
减：所得税费用	279,673,275.57	395,123,144.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	823,071,432.87	1,433,790,911.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	823,071,432.87	1,433,790,911.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,684,552,665.08	1,905,779,004.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-861,481,232.21	-471,988,093.70
六、其他综合收益的税后净额	26,797,092.78	-366,459,854.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-123,605,028.00	-375,789,463.42
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-123,605,028.00	-375,789,463.42
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	150,402,120.78	9,329,608.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	150,402,120.78	9,329,608.49
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	849,868,525.65	1,067,331,056.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	1,711,349,757.86	1,539,319,150.03

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-861,481,232.21	-471,988,093.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.20	1.46
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.20	1.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张素心

主管会计工作负责人：Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）

会计机构负责人：黄英娜

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：华虹半导体有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,210,656,187.22	13,201,096,509.78
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	234,597,511.48	375,688,169.49
收到其他与经营活动有关的现金	551,964,603.40	645,431,722.63
经营活动现金流入小计	13,997,218,302.09	14,222,216,401.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,927,220,328.91	6,534,947,902.89
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,105,722,242.16	2,430,360,192.20
支付的各项税费	868,770,822.14	721,115,048.94
支付其他与经营活动有关的现金	633,117,599.24	608,600,116.88
经营活动现金流出小计	10,534,830,992.45	10,295,023,260.91
经营活动产生的现金流量净额	3,462,387,309.64	3,927,193,140.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	40,518,146.63
取得投资收益收到的现金	-	422,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,144.42	730,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	171,144.42	41,671,146.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,044,314,052.06	4,407,720,497.69
投资支付的现金	-	19,200,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,044,314,052.06	4,426,920,497.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,044,142,907.64	-4,385,249,351.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,002,306,239.36	2,817,796,274.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,035,374,642.00	2,787,198,400.00
取得借款收到的现金	2,645,293,116.17	2,238,520,836.73
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	25,647,599,355.53	5,056,317,111.07
偿还债务支付的现金	2,624,720,412.24	1,026,801,852.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,552,579.63	108,709,628.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	265,279,083.49	57,488,287.68
筹资活动现金流出小计	3,324,552,075.36	1,192,999,769.11
筹资活动产生的现金流量净额	22,323,047,280.17	3,863,317,341.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,085,230.62	394,066,029.68
五、现金及现金等价物净增加额	21,833,376,912.79	3,799,327,161.57
加：期初现金及现金等价物余额	13,990,243,081.09	10,265,769,065.18
六、期末现金及现金等价物余额	35,823,619,993.88	14,065,096,226.75

公司负责人：张素心

主管会计工作负责人：Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）

会计机构负责人：黄英娜

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日